

AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

Technische Merkmale

Lieferbare Polzahlen <i>Available Number of Positions</i>	55, 110, 125, 176, 200
Raster <i>Centerline</i>	2 mm
Gehäusematerial <i>Housing Material</i>	Polyester, UL 94 V-0
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	CuSn Phosphor bronze
Oberfläche Kontaktbereich <i>Finish Contact Area</i>	0,8 µm Au/1,3 µm Ni 0.8 µm Gold/1.3 µm Nickel
Oberfläche ACTION PIN-Bereich <i>Finish ACTION PIN Area</i>	0,5 µm SnPb/1,3 µm Ni 0.5 µm Tin-lead/1.3 µm Nickel
Leiterplattendicke <i>PC Board Thickness</i>	1,4 mm min. – 4,2 mm max.
Steckkraft <i>Mating Force</i>	0,70 N pro Kontakt 0.70 N per Contact
Kontrollierte Normalkraft <i>Controlled Normal Force</i>	0,80 N pro Kontakt 0.80 N per Contact
Nennspannung <i>Current Voltage</i>	1,5 A (70 °C)
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	<20 mΩ
Kontrollierte Impedanz <i>Controlled Impedance</i>	50 Ω ±10%

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

Technical Features

AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

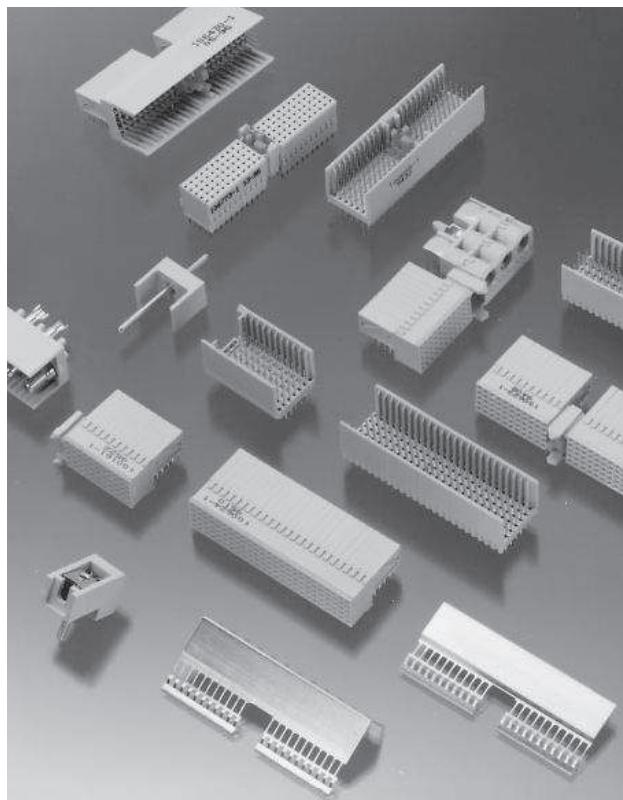
Die Entwicklung von Systemen für Computer, industrielle Meßausführungen und für die Telekommunikation ist von ständig höherer Packungsdichte und immer schnelleren Signalanstiegszeiten gekennzeichnet. Durch die erheblich gestiegenen Anforderungen verlangt der Markt auch im Steckverbinderbereich schnell verfügbare, kosten-günstige Hochleistungs-Systeme.

Das hart metrische Z-Pack 2 mm HM Steckverbinder-System trägt diesen Anforderungen Rechnung und internationale Standardisierungs-Komitees haben die hohe Leistungsfähigkeit dieses Systems anerkannt.

Das Z-Pack 2 mm HM Steckverbinder-System von AMP wurde entwickelt, um den Anforderungen an digitale Übertragungs-Systeme mit hohen Übertragungsraten gerecht zu werden. Dabei kombiniert dieses System Flexibilität durch hohe Packungsdichte mit hoher Leistungsfähigkeit. Es ist vollständig modular aufgebaut und eignet sich für Leiterplatte-an-Leiterplatte und Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen und entspricht den metrischen Spezifikationen der IEC 917 (DIN 43355) und der IEC 1076-4-101.

Dieses System hat auch die Bellcore-Qualifikation gemäß TR-NWT-001217 erhalten. In dem Test sind die allgemeinen Anforderungen an Steckverbinder-Systeme für den Gebrauch in der Hardware für die Telekommunikations-Industrie festgelegt.

Neben der 5reihigen 2 mm Standard-Version und der 5 + 2reihigen Matrix mit niedrigem Übersprechverhalten und eingebautem Erdungsblech gibt es heute auch eine 8reihige Version, die bis zu 200-polige Module zuläßt. Kein anderes System auf dem Markt bietet die entsprechende Packungsdichte mit 23 Stiften pro Quadrat-Zentimeter auf der Leiterplatte. Eine weitere Version mit 8 + 2reihiger Matrix mit erweiterter elektrischer Leistungsfähigkeit ist gleichwohl verfügbar.



AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

The development of systems for Computer, Industrial Measurement Equipment and for Telecommunications is marked by the constant demand for higher packaging density and ever faster signal rise-times. Along with the considerably increased performance requirements, the market demands readily available, attractively priced connector systems.

The true hard metric Z-PACK 2 mm HM connector system meets these requirements and its high performance capabilities have been recognized by several international standards committees.

AMP's Z-PACK 2 mm HM connector system was developed to fulfill the need for high speed transmission rates in digital transmission systems. In the process this system shows its flexibility by combining high packaging density with high performance. It is completely modular in structure and is suitable for board-to-board and cable-to-board applications. It corresponds to the metric specifications of the IEC 917 (DIN 43355) and the IEC 1076-4-101.

This system has been qualified according to the Bellcore TR-NWT-001217. This test includes the common requirements for use of connector systems in hardware for the telecom industry.

Along with the standard 5 row version and the 5 + 2 matrix with low crosstalk and built-in ground shield there is now also an 8 row version which allows modules up to 200 positions. No other system on the market offers the corresponding packaging density of 23 contacts per square centimeter on the pc board. A further 8 + 2 row matrix version with extended electrical performance capabilities is likewise available.

Technische Merkmale

- Hart Metrisch nach IEC 917 (DIN 43355) und IEC 1076-4-101
- Modulares System
 - Leiterplatte-an-Leiterplatte
 - Kabel-an-Leiterplatte
- anpaßbar an Kunden-Anforderungen
 - Packungsdichte
 - elektrische Leistungsfähigkeit
- Signal-Anstiegszeit < Nanosek. für Telekommunikation, Großrechner, Industriesteuerungen, medizinische Systeme, Meßgeräte
- Signalkontakte Stromtragfähigkeit 1,5 A (70 °C)
- ACTION PIN-Technologie für die Mutter- und Tochter-Platten
- auch zur Bellcore-Spezifikation TR-NWT-001217 geeignete Teile vorhanden
- breite Auswahl von günstigen Erweiterungsmöglichkeiten
- neue Miniatur-Steckverbinder für Lichtwellenleiter (MSC) für erhöhte Packungsdichte, dadurch kein Druck auf die Rückwandplatine in gestecktem Zustand
- geschirmte und ungeschirmte Kabelsteckverbinder
- Kabel-Assemblies werden von AMP nach kundenspezifischen Wünschen gefertigt
- Analyse und Simulation des Kundendesigns ist von AMP durchführbar

Technical Features

- Hard metric according to IEC 917 (DIN 43355) and the IEC 1076-4-101
- Complete modular system
 - Board-to-Board
 - Cable-to-Board
- Meets customer requirements for
 - signal contact density
 - electrical performance
- Signal rise times in sub-nano-second range for telecommunications, high performance data processing, industrial process controls, medical systems and instrumentation
- Signal contacts rated at 1.5 A (70 °C)
- ACTION PIN technology for mother and daughter boards
- Available a Bellcore qualified by TR-NWT-001217
- Wide range of standard options for economy
- New MSC fiber optic plugs for increased circuit density and zero force on backplane when mated
- Unshielded and shielded cable connectors
- Cable assemblies produced by AMP to specific customer requirements
- Supported by modelling services from AMP

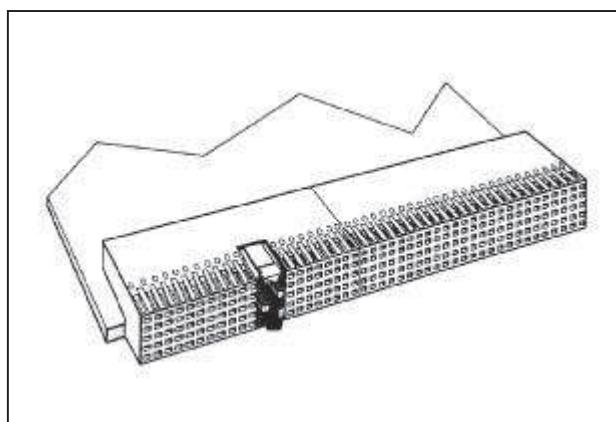
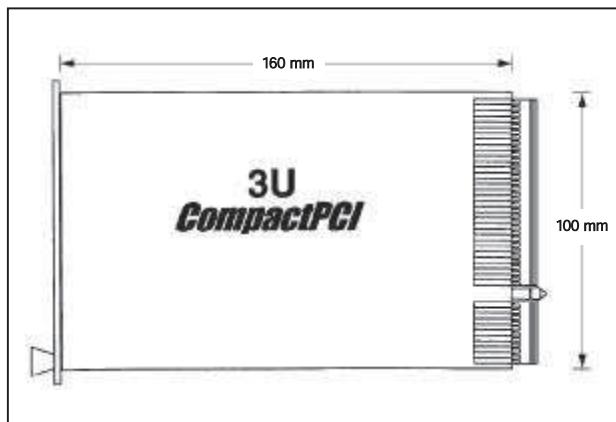
AMP Z-PACK 2 mm HM Compact PCI Steckverbinder-System

Einleitung

Der Compact PCI (Peripheral Component Interconnect) ist ein abgewandelter PCI, der für industrielle Anwendungen bestimmt ist, die eine erhöhte elektrische und mechanische Leistung erfordern.

Dieser neue Hardware-Standard wurde entwickelt, um die Rechnerleistungen für Meßgeräte, Verarbeitungs-Automatisierung, Telekommunikation und weitere anspruchsvolle Anwendungen zu steigern.

Einige der für den Compact PCI geforderten Eigenschaften sind unten aufgeführt.



AMP Z-PACK 2 mm HM Compact PCI Interconnection System

Introduction

The Compact PCI (peripheral Component Interconnect) is an adaption of PCI suitable for ruggedized/industrial/embedded applications requiring enhanced electrical and mechanical performance.

This new hardware standard is designed to significantly increase computing power for demanding, machine control, process automation and telecommunication's applications.

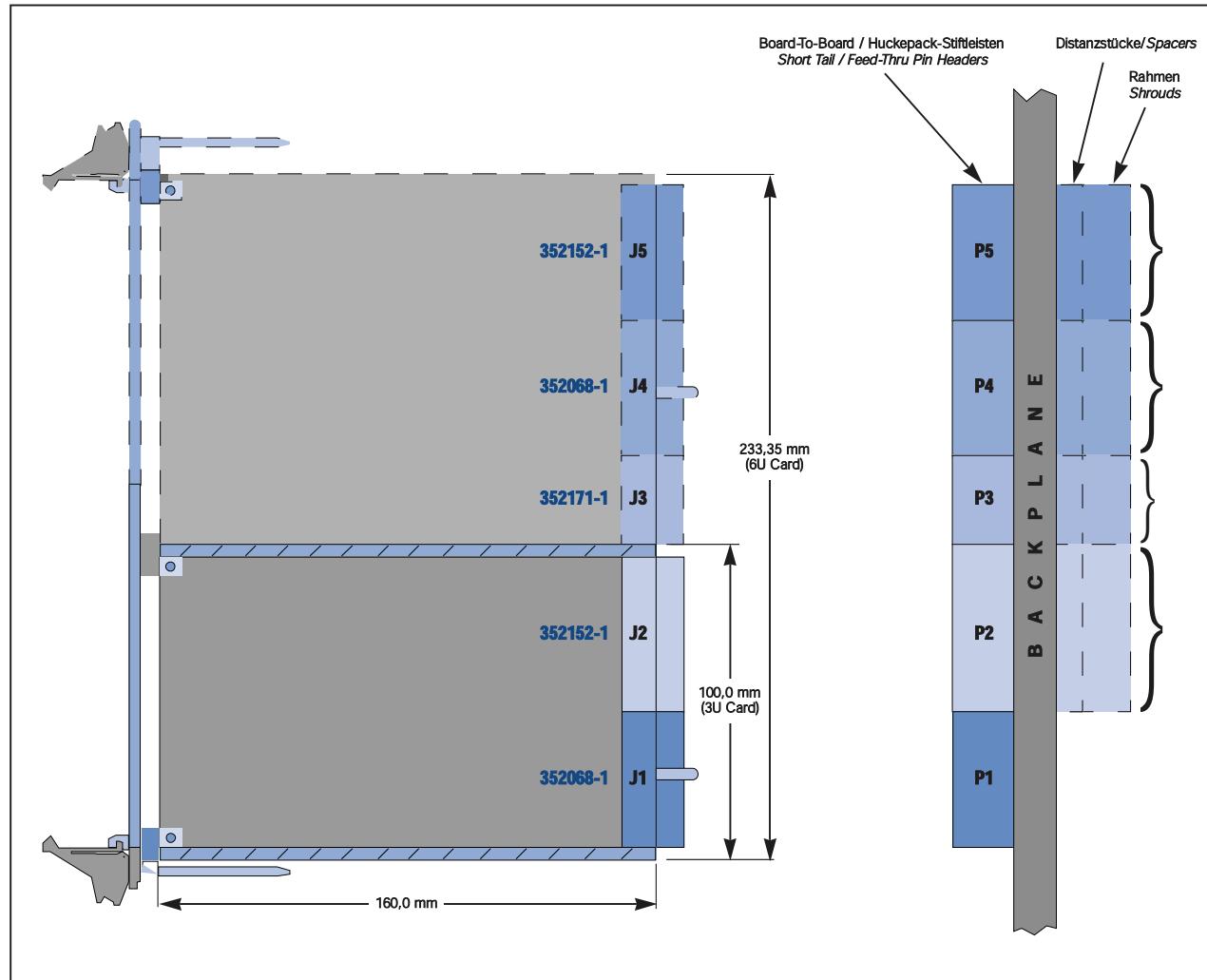
Some of the features required by the Compact PCI include are listed below.

Technische Merkmale

- Stift- und Buchsen-Verbindungs-Technik
- Breite Verfügbarkeit
- Versetzte, voreilende Stifte für sequentielle Kontaktgabe
- Hohe Packungsdichte mit PCI-Fähigkeit
- Hohes Erdung/Signal-Verhältnis
- Schirmung für EMI-/RFI-Schutz
- Kodiermechanismus für positives Stecken
- Stifteleiste mit Kabeldurchführung zur Rückplatine
- Erweiterbarkeit (Leistungsskalierbarkeit) für Anwendungen des Endverbrauchers

Technical Features

- Pin and socket connector
- Multi vendor support
- Staggered make-break pins for sequencing and hot swapping
- High density PCI capability
- High ground/signal ratio
- Shielding for EMI/RFI protection
- Coding mechanism providing positive keying
- Feed-through pin header option for cabling to backplane
- Expandability (performance scalability) for end user applications

**AMP Z-PACK 2 mm HM
Steckverbinder-System**Compact PCI und
VME 64**Compact PCI Formfaktor****AMP Z-PACK 2 mm HM
Interconnection System**Compact PCI and
VME 64**Compact PCI Form Factors**

Capital Goods

Wegen ihrer hohen Dichte, der Anreichbarkeit ohne Rasterverlust sowie der Profil-Kompatibilität mit den Steckverbindern gemäß DIN 41612/IEC 60603-2 wurden die AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder für die elektrische Verbindung bei Compact PCI-Systemen und VME 64x-Erweiterungen gewählt.

Für CPCl 32 bit- und 64 bit-Syste me mit 3 HE Karten (P1-2/J1-2) und mit 6 HE Karten (P1-5/J1-5) sowie für die VME 64x-Erweiterungen zwischen den VME 64x-Steckverbindern werden sowohl Standard-Versionen als auch Steck-

verbinder mit unterschiedlichen Pfostenlängen eingesetzt.

Steckverbinder für Tochterkarten, Backplane- oder Midplane-Applikationen sind verfügbar, letztere mit Distanzstücken und entsprechenden Aufnahmerahmen für die Rückseite. Standard AMP HM Steckverbinder für Kabelanbindungen können mit den dazugehörigen Aufnahmerahmen ebenfalls verwendet werden.

180°-Federleisten erlauben Applikationen in Sandwich-Bauweise, um die Flexibilität der Module zu erhöhen.

AMP Z-PACK 2 mm HM shielded connectors have been chosen for the interconnection of both Compact PCI and VME 64 Extensions because of high density, sequencing levels and profile compatibility with IEC Eurocard connectors.

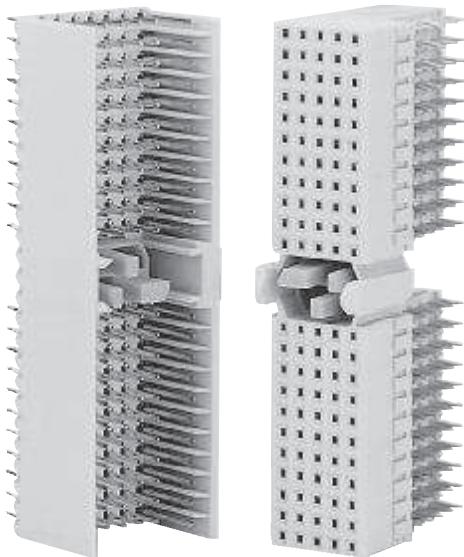
C-PCI 32 bit and 64 bit on 3U cards (P1-2/J1-2) and on 6U cards (P1-5/J1-5) use standard and special length connectors, with one of these also being used between the two Eurocard connectors J1/P1 and J2/P2 on VME 64 Extensions.

Backplane and daughter card connectors for single side or midplane applications are listed, the latter using corresponding spacers and shrouds for the backplane rear. Standard AMP HM cable connectors can be used with appropriate shrouds.

Vertical receptacles allow the use of mezzanine cards to extend or increase card application flexibility.

**AMP Z-PACK 2 mm HM
Steckverbinder-System****Stift- und Buchsen-
Steckverbinder****Typ A**

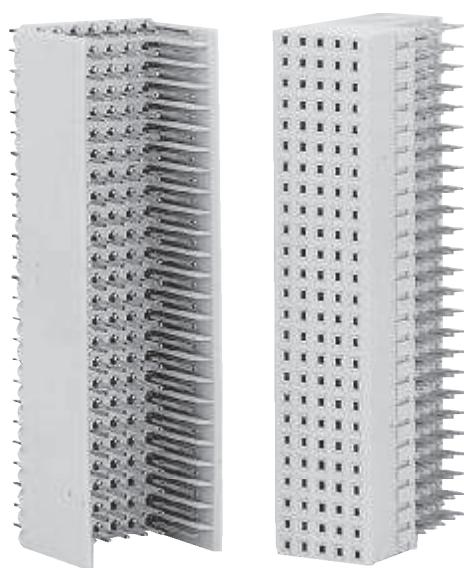
110 Signalkontakte, 50 mm Module. Service-Center mit mechanischer Vorführung, Polarisierung und Kodiermodule mit numerischer und farblicher Kennung.



Capital Goods

Typ B

125 Signalkontakte, 50 mm Module. Diese Ausführung wird normalerweise zwischen Typ A oder anderen Modulen mit Sonderkontakte eingesetzt.

**Typ C**

55 Signalkontakte, 25 mm Module mit Polarisierung. Wird am Ende anreihbarer Module benutzt.

**AMP Z-PACK 2 mm HM
Interconnection System****Male and Female
Connectors****Type A**

110 signal contacts, 50 mm modules with integral guide lugs for polarized mating, also multi-purpose center for coding keys.

Type B

125 signal contacts, 50 mm modules. Preferably used between Type A, C, M, L or N modules, also Type M-MSC, M-MSC-rev and L-MSC, with polarizing guide lugs.

Type C

55 signal contacts, 25 mm modules with guide lugs for polarized mating. Used at end of stacked modules.

**Typ A, Tochterkarte
Buchsenstecker,
Standard und reduziertes
Übersprechen**

**110polig,
50 mm Module
mit Service-Center**

Standard-Version:
Best.-Nr. **100147-1**

Packungseinheit:
11 Stück

**Reduzierte
Übersprechungs-Version:**
Best.-Nr. **100623-1**

Packungseinheit:
11 Stück



**Type A, Free Board
Female Connector,
Standard and
Reduced Crosstalk**

**110 Positions,
50 mm Module
with Multi-Purpose Center**

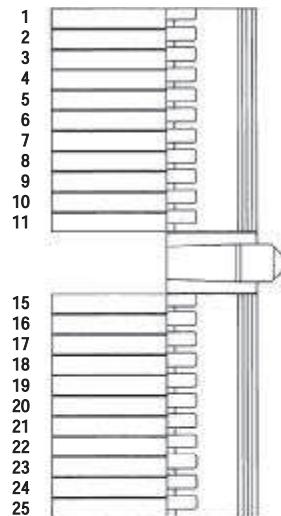
Standard Version:
Part No. **100147-1**

Packaging Unit:
11 Pieces

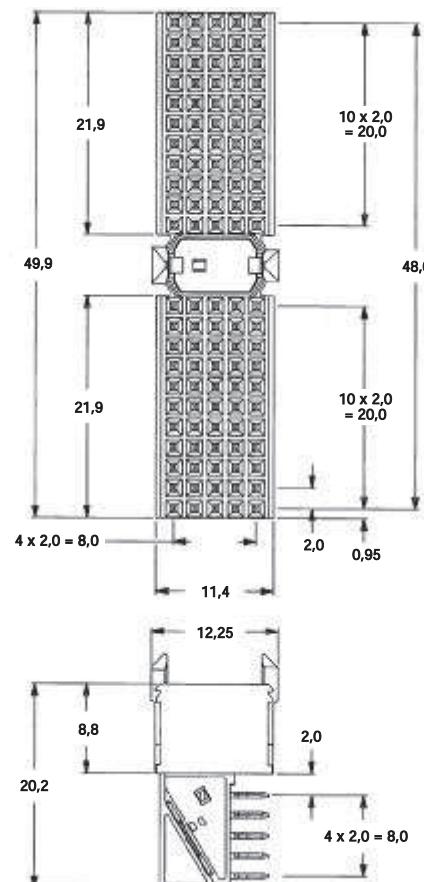
**Reduced
Crosstalk Version:**
Part No. **100623-1**

Packaging Unit:
11 Pieces

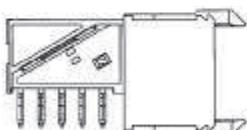
Längsreihen/Columns



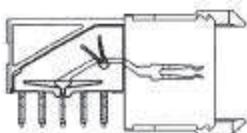
Querreihen/Rows e d c b a



Standard



reduziertes Übersprechen/Reduced Crosstalk



**Reihe c für Erdung
Row c to Ground**

**Typ B, Tochterkarte
Buchsenstecker,
Standard und reduziertes
Übersprechen**

**125polig,
50 mm Modul**

**Standard-Version:
Best.-Nr. 100145-1**

**Packungseinheit:
11 Stück**

**Reduzierte
Übersprechungs-Version:
Best.-Nr. 100624-1**

**Packungseinheit:
11 Stück**

**Type B, Free Board
Female Connector,
Standard and
Reduced Crosstalk**

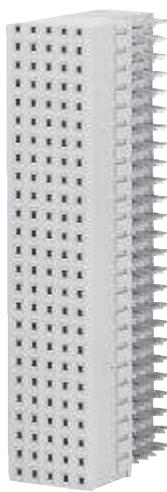
**125 Positions,
50 mm Module**

**Standard Version:
Part No. 100145-1**

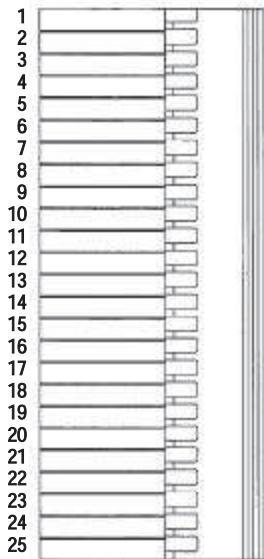
**Packaging Unit:
11 Pieces**

**Reduced
Crosstalk Version:
Part No. 100624-1**

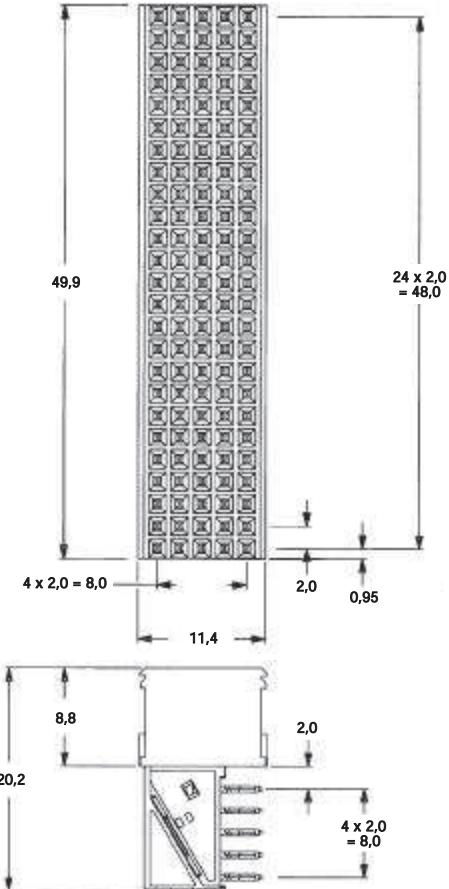
**Packaging Unit:
11 Pieces**



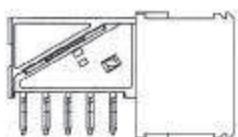
Längsreihen/Columns



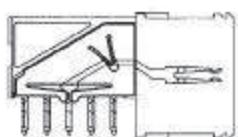
Querreihen/Rows e d c b a



Standard



reduziertes Übersprechen/Reduced Crosstalk



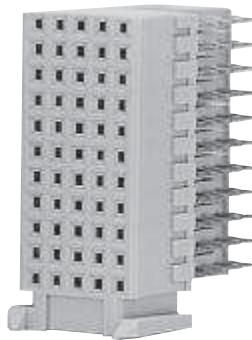
e d c b a
Reihe c für Erdung
Row c to Ground

**Typ C, Tochterkarte
Buchsenstecker,
Standard und reduziertes
Übersprechen**

**55polig,
25 mm Module
mit Führungsstiften**

**Standard-Version:
Best.-Nr. 100161-1**

**Packungseinheit:
22 Stück**



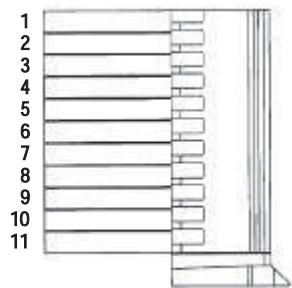
**Type C, Free Board
Female Connector,
Standard and
Reduced Crosstalk**

**55 Positions,
25 mm Module
with Guide Lugs**

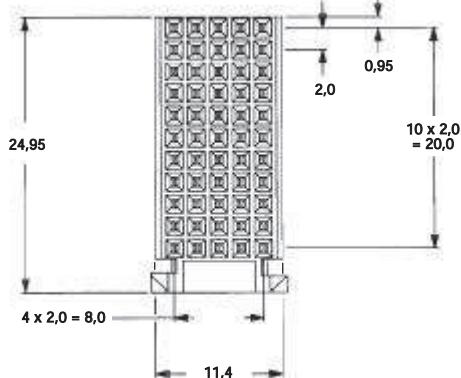
**Standard Version:
Part No. 100161-1**

**Packaging Unit:
22 Pieces**

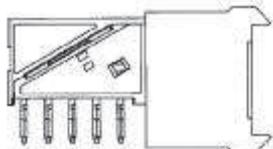
Längsreihen/Columns



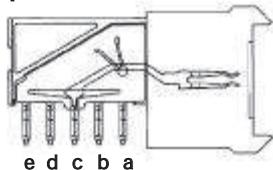
Querreihen/Rows e d c b a



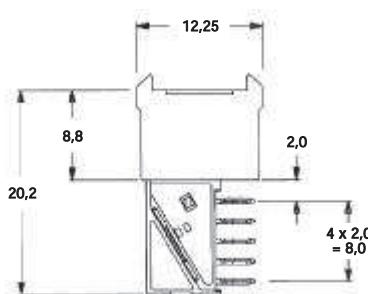
Standard



reduziertes Übersprechen/Reduced Crosstalk



**Reihe c für Erdung
Row c to Ground**



Typ A**Rückwandplatine
Stifteleiste****110polig,
50 mm Module
mit Service-Center**

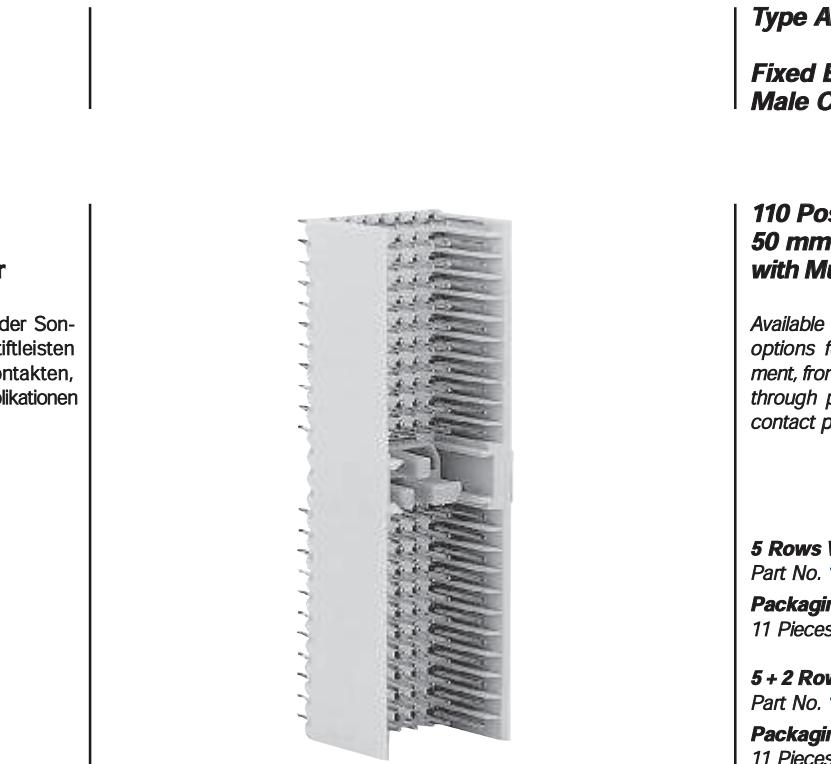
Lieferbar mit Standard- oder Sonder-Ausführungen für Stifteleisten mit voreilenden Signalkontakten, Rückwand „Midplane“-Applikationen und Erdungsstiften.

5reihige Version:
Best.-Nr. **100143-1**

Packungseinheit:
11 Stück

5 + 2reihige Version:
Best.-Nr. **100668-1**

Packungseinheit:
11 Stück

**Type A****Fixed Board
Male Connector****110 Positions,
50 mm Module
with Multi-Purpose Center**

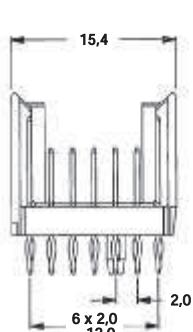
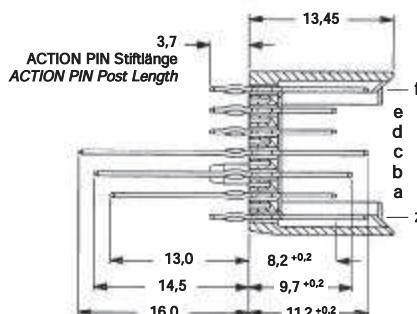
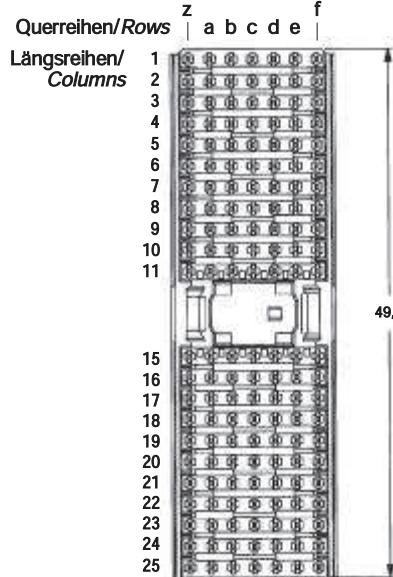
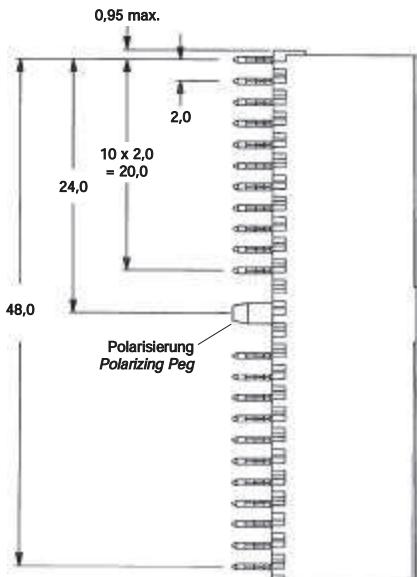
Available with standard or special options for contact pin arrangement, front mating levels, rear feed-through posts and ground return contact pins.

5 Rows Version:
Part No. **100143-1**

Packaging Unit:
11 Pieces

5 + 2 Rows Version:
Part No. **100668-1**

Packaging Unit:
11 Pieces



Länge der Stifte Vorder- und Rückseite optional.
Rear feed-through post mating length options, Front mating level options.

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.

Typ B**Rückwandplatine
Stifteleiste****125polig,
50 mm Module**

Lieferbar mit Standard- oder Sonder-Ausführungen für Stifteleisten mit voreilenden Signalkontakten, Rückwand „Midplane“-Applikationen und Erdungsstiften.

5reihige Version:
Best.-Nr. **100141-1**

Packungseinheit:
11 Stück

5 + 2reihige Version:
Best.-Nr. **100669-1**

Packungseinheit:
11 Stück

**Type B****Fixed Board
Male Connector****125 Positions,
50 mm Module**

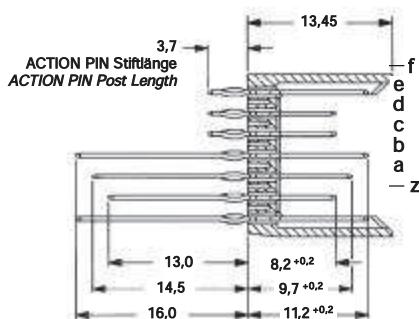
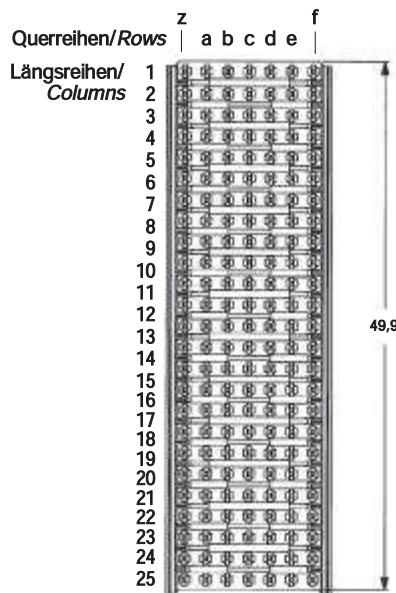
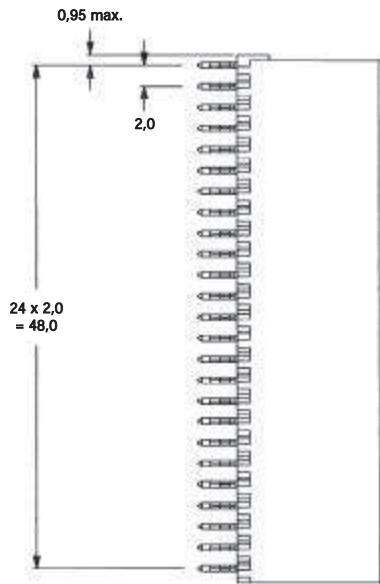
Available with standard or special options for contact pin arrangement, front mating levels, rear feed-through posts and ground return contact pins.

5 Rows Version:
Part No. **100141-1**

Packaging Unit:
11 Pieces

5 + 2 Rows Version:
Part No. **100669-1**

Packaging Unit:
11 Pieces



Länge der Stifte Vorder- und Rückseite optional.
Rear feed-through post mating length options, Front mating level options.

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.

Typ C**Rückwandplatine
Stifteleiste****55polig,
25 mm Module**

Lieferbar mit Standard- oder Sonder-Ausführungen für Stifteleisten mit voreilenden Signalkontakten, Rückwand „Midplane“-Applikationen und Erdungsstiften.

5reihige Version:
Best.-Nr. **100159-1**

Packungseinheit:
22 Stück

5 + 2reihige Version:
Best.-Nr. **106081-1**

Packungseinheit:
22 Stück

**Type C****Fixed Board
Male Connector****55 Positions,
25 mm Module**

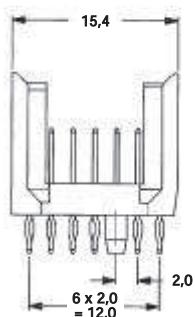
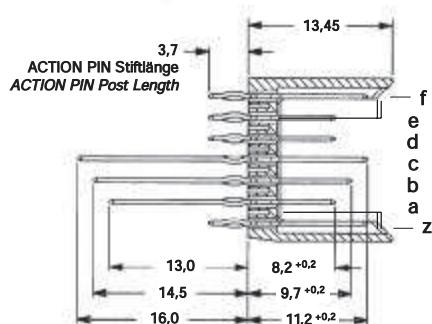
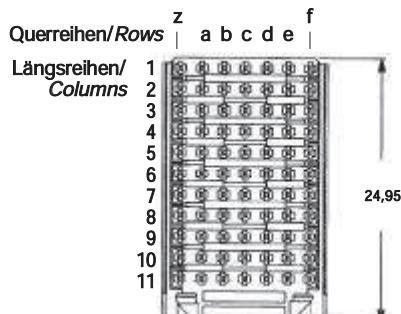
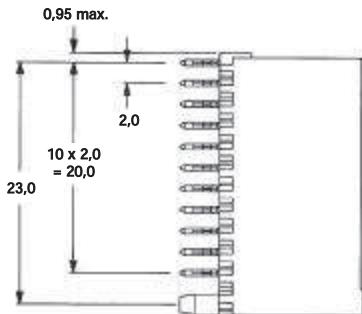
Available with standard or special options for contact pin arrangement, front mating levels, rear feed-through posts and ground return contact pins.

5 Rows Version:
Part No. **100159-1**

Packaging Unit:
22 Pieces

5 + 2 Rows Version:
Part No. **106081-1**

Packaging Unit:
22 Pieces



Länge der Stifte Vorder- und Rückseite optional.
Rear feed-through post mating length options, Front mating level options.

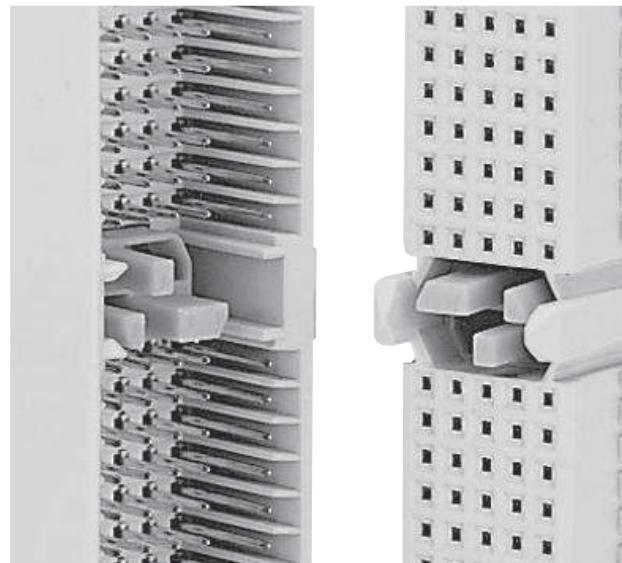
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.

**Kodierungsmodule
für Typ A, M und L
Stift- und
Buchsenstecker**

**Kodierungsmodule
für Stift- und Buchsen-
stecker in gleicher
Farbe und ergänzender
Numerierung**

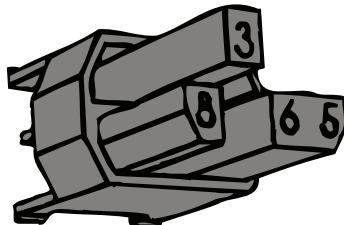
**Coding Keys
for Type A, M and L
Male and
Female Connectors**

**Coding Key Set
with Combinations
of Matching Colors
and Complementary
Numbering**



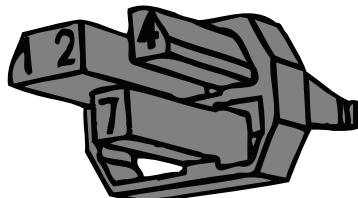
**Kodierungs-Schlüssel
für Stiftstecker**

**Coding Key
for Male Connectors**



**Kodierungs-Schlüssel
für Buchsenstecker**

**Coding Key
for Female Connectors**



Farbe Color	Bestell-Nummern/Part Numbers		Packungs- einheit Packaging Unit
	Stiftstecker Male Connector	Buchsenstecker Female Connector	
Brilliant-Blau Brilliant Blue	3-100525-2	3-100526-2	500
Cadmium-Gelb Cadmium Yellow	5-100525-6	5-100526-6	500

**Erdungsblech
für Typ A, B, C, M,
M-MSC und M-MSC-rev
Steckverbinder**

**Oberes und
unteres Erdungsblech
für Buchsenstecker**

Lieferbar für Typ A, B, C, auch M und M-MSC Steckverbinder in Standard- oder Reduzierten Übersprechungs-Ausführungen.

Die Schirmungsbleche sind mit AMP ACTION PIN-Kontakten ausgestattet um eine Press-Fit, lötfreie Verbindung mit der Tochterkarte sicherzustellen. Sie benutzen eine extra Reihe (F) von durchplattierten Bohrlöchern in der Leiterplatte mit der gleichen Größe wie bei Signalkontakte.

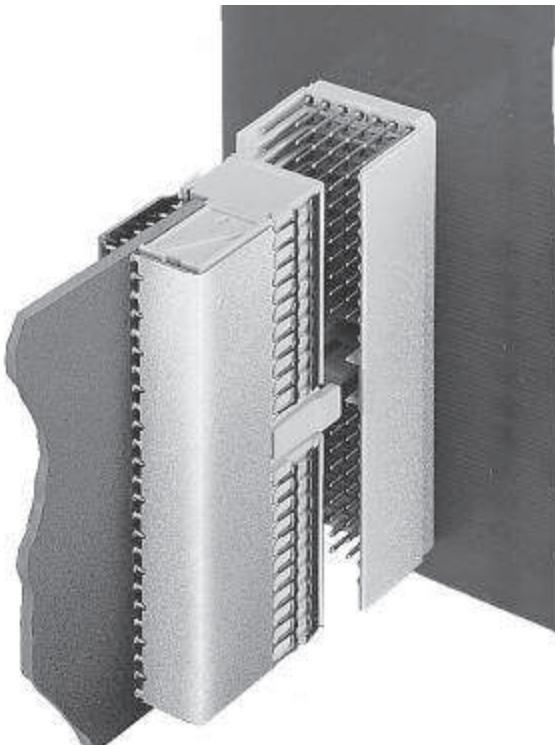
Optionen

Schirmung kann mit beiden Teilen benutzt werden oder auch nur mit dem Oberen oder dem Unteren Schirmblech. Der obere Schirm ist am Gehäuse vormontiert.

Verarbeitung

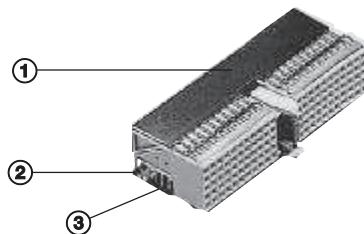
Einpressung von jedem Schirmblech nachdem der Steckverbinder auf der Tochterplatine montiert wurde.

Obere Erdungsblechkontakte sind in den ungeraden Reihenstellungen und die unteren in den geraden.



Typ A

- ① Oberes Schirmblech (vormontiert)
- ② ACTION PIN-Kontakte
- ③ Unteres Schirmblech



**Ground Return Shields
for Type A, B, C, M,
M-MSC and M-MSC-rev
Connectors**

**Upper and Lower
Ground Return Shields
for Female Connectors**

Available for Type A, B, C, also M, M-MSC, M-MSC-rev connectors in standard or reduced crosstalk versions.

Shields have ACTION PIN contacts for press-fit, solderless connection in the free board, using one extra row (F) of plated through holes, same size as for signal contacts.

Options

Shielding can be upper and lower, upper only, lower only. For upper shielding a complete assembly including the receptacle is provided.

Installation

By press-in of each shield after mounting of connectors on the free board.

Upper shield ACTION PIN contacts located in odd no. column positions, lower shield in even nos.

Type A

- ① Upper Shield Assembly
- ② ACTION PIN Contacts
- ③ Lower Shield

Typ B

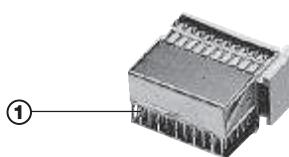


Type B

Typ C

Für Typ C und M-MSC-rev Steckverbinder Signalstifte Spalten 1 bis 11, auch M und M-MSC Steckverbinder Spalten 15 bis 25.

- ① ACTION PIN-Kontakte



Type C

for Type C and M-MSC-rev connector signal pin columns 1 to 11, also M and M-MSC connector columns 15 to 25.

- ① ACTION PIN Contacts

**Erdungsblech
für Typ A, B, C, M,
M-MSC und M-MSC-rev
Steckverbinder
(Fortsetzung)**

Tochterkarte-Leiterplattendicke:
min. 1,4 mm, max. 3,5 mm
nur für unteres Erdungsblech

Material und Oberfläche

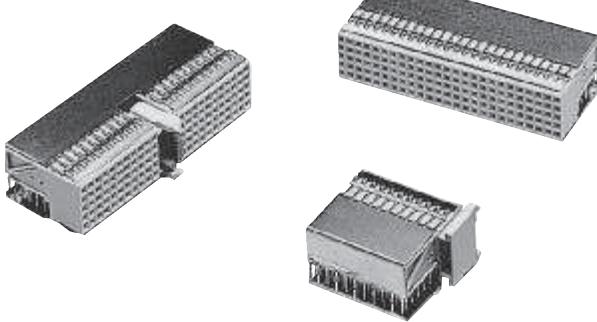
Material:
CuSn

Nachplattierung

Erdungsblech:
1,3 µm Ni

Kontaktbereich:
0,8 µm Au

ACTION PIN-Stiftbereich:
0,5 µm SnPb



**Typ A, Oberes Schirmblech vormontiert
Type A, Upper Shield Assembly**

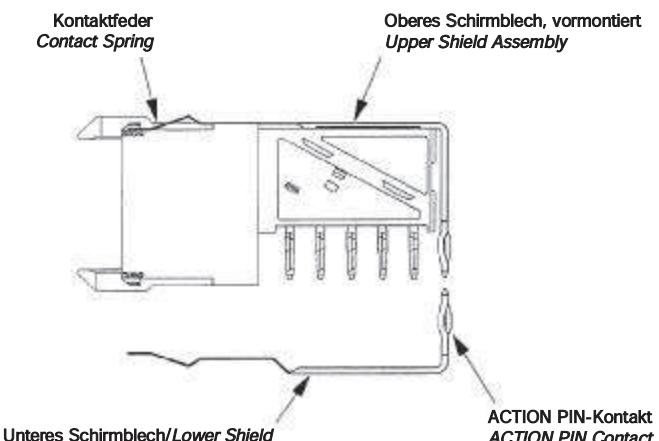
Best.-Nr./Part No. **352068-1**

**Typ B, Oberes Schirmblech vormontiert
Type B, Upper Shield Assembly**

Best.-Nr./Part No. **352069-1**

**Typ C, Oberes Schirmblech vormontiert
Type C, Upper Shield Assembly**

Best.-Nr./Part No. **352115-1**



**Typ A, Unteres Schirmblech
Type A, Lower Shield**

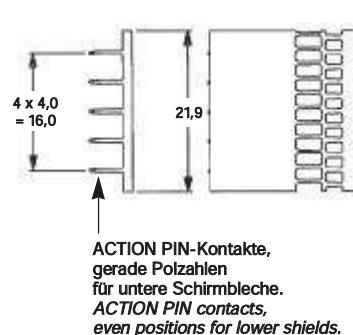
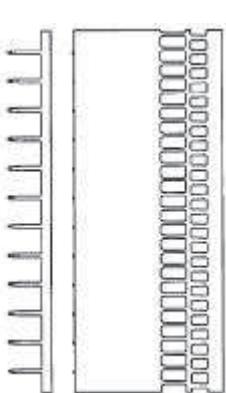
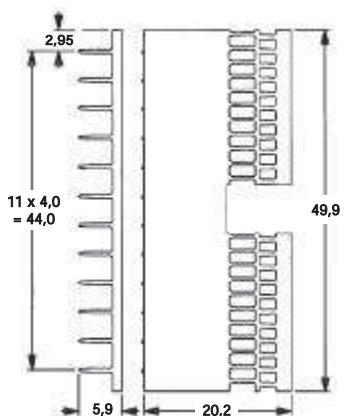
Best.-Nr./Part No. **338108-2**

**Typ B, Unteres Schirmblech
Type B, Lower Shield**

Best.-Nr./Part No. **338110-2**

**Typ C, Unteres Schirmblech
Type C, Lower Shield**

Best.-Nr./Part No. **352112-2**



Werkzeuganordnung für die Einsetzung von Buchsen- und Stiftgehäuse

Einführung

Steckverbinder-Module in 25 mm oder 50 mm-Ausführung werden einzeln in beliebiger Reihenfolge eingesetzt, je nachdem welche Reihenfolge am besten für den Aufbau der Leiterplatte geeignet ist.

Die allgemeine Anordnung des Werkzeugs für Stifte und Buchsen gilt für AMP Einsetz-Werkzeuge. Das schnelle Auswechseln des Werkzeuges für den entsprechenden Steckverbinder-Typ sorgt für eine optimale Produktivität.

Bei Kunden vorhandene Pressen können eingesetzt werden, indem der obere und der untere Adapter der Befestigungsschiene herausgenommen wird. Oberer Adapter und unteres Einsetz-Modul können dann an das vorhandene Werkzeug angepaßt werden.

Tooling Arrangements for Female and Male Connector Insertion

Introduction

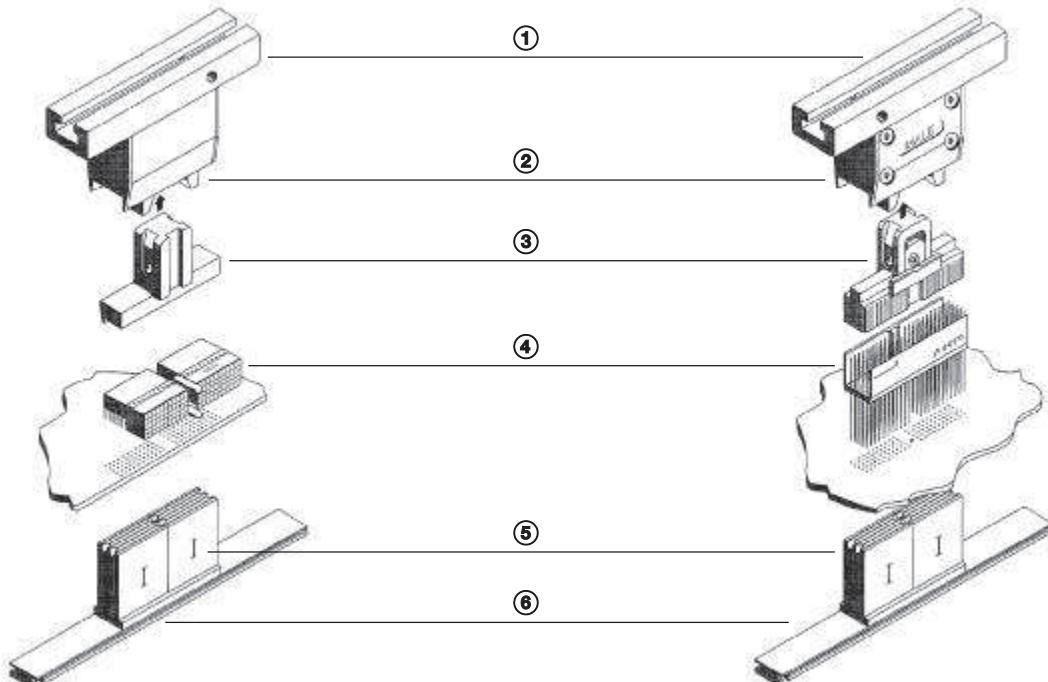
Connectors modules, 50 mm or 25 mm, are inserted one at a time, in whatever order is best suited for the make-up of boards.

General arrangements of tooling for female and male connectors are shown for use with AMP insertion presses. Rapid change-over of tooling for each type of connector brings optimum productivity.

Use with existing customer presses is easily handled by omitting top and bottom adaptor mounting bars, and fitting top adaptors and bottom insert modules to existing tooling.

Einsetzen der Buchse Female Connector Insertion

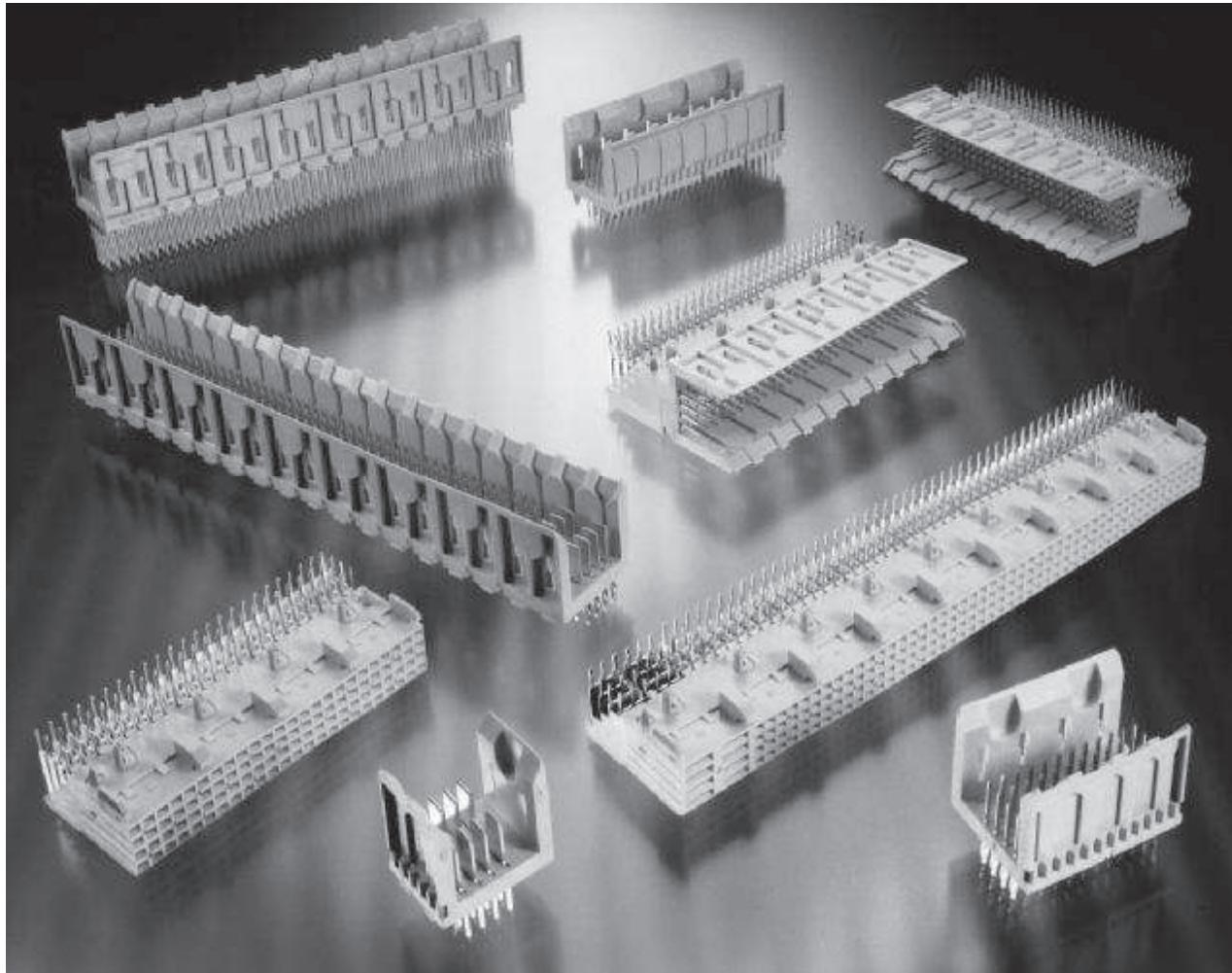
Einsetzen des Stiftes Male Connector Insertion



- ① Obere Schiene des Adapters für AMP Einsetz-Werkzeug
- ② Adapter
- ③ Oberer Einsatz
- ④ Steckverbinder
- ⑤ Stütze für die Leiterplatte
- ⑥ Untere Schiene des Adapters für AMP Einsetz-Werkzeug

- ① Upper Adaptor Bar for AMP Insertion Press
- ② Adaptor
- ③ Upper Insert
- ④ Connector
- ⑤ PC Board Support Modules
- ⑥ Lower Adaptor Bar for AMP Presses

**AMP Produkte
für IndustrialPCI
(IPCI)**



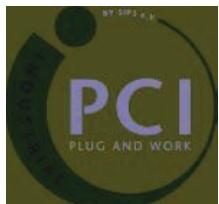
**AMP ist seit 1. 1. 1997 Mit-
glied im IndustrialPCI e.V.**

AMP unterstützt die Interessen des IPCI auch mit entsprechenden Produkten.

Die Leiterplatten-Steckverbinder entsprechen der AMP Steckverbinder-Familie **Z-PACK 2 mm FB**.

Wir bieten von der Simulation, über die Steckverbinder bis zur komplett bestückten Rückwandplatine die Möglichkeit des „Full-Services“.

Rufen Sie uns an!



Aufgaben und Ziele des SIPS e.V.

- Definition und Standardisierung des IndustrialPCI auf der Basis des PCI Local Bus der PCI-SIG
- Förderung der nationalen und internationalen Verbreitung des IndustrialPCI Bus
- Förderung der nationalen und internationalen Normungsbestrebungen für den IndustrialPCI Bus
- Information der Fachöffentlichkeit über den technischen Stand, die Anwendung und Weiterentwicklung des IndustrialPCI Bus
- Teilnahme an Fachmessen und Tagungen
- Veranstaltung von Fachseminaren
- Beratung der Mitglieder beim Einsatz des IndustrialPCI-Bus
- Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Verbänden
- Zusammenarbeit mit Hochschulen
- Einrichtung einer Zertifizierungsstelle zur Konformitätsprüfung

**AMP has been a Member
of IndustrialPCI e.V.
since 1. 1. 1997**

AMP supports the IPCI interests and also supplies appropriate products.

The board-to-board connectors comply with the AMP Z-PACK 2 mm FB connector family.

We offer full service, from simulation to the connector itself to completely assembled backplanes.

Give us a call!



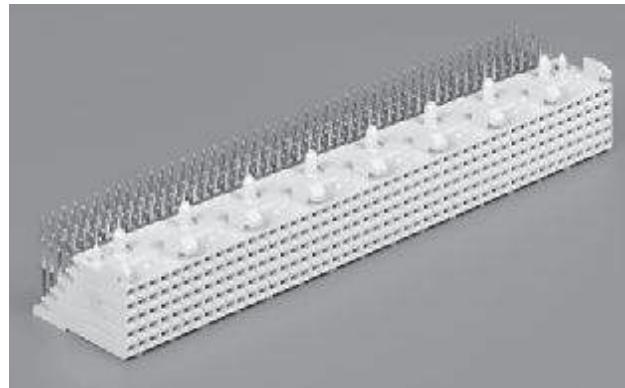
Tasks and Targets of the SIPS e.V.

- Definition and standardization of the IndustrialPCI based on the PCI-SIG PCI Local Bus
- To advance the national and international distribution of the IndustrialPCI bus
- To advance the national and international standardization effort for the IndustrialPCI bus
- To inform the public about the technical status, the use and the development of the IndustrialPCI bus
- To participate in fairs and conferences
- To arrange seminars
- Consult members when using the IndustrialPCI bus
- Collaborate with research centers and associations
- Collaborate with universities and high schools
- Establish a certification center to approve conformity

**AMP Produkte
für IndustrialPCI (IPCI)
(Fortsetzung)****AMP Z-PACK 2 mm FB
5 Reihen**

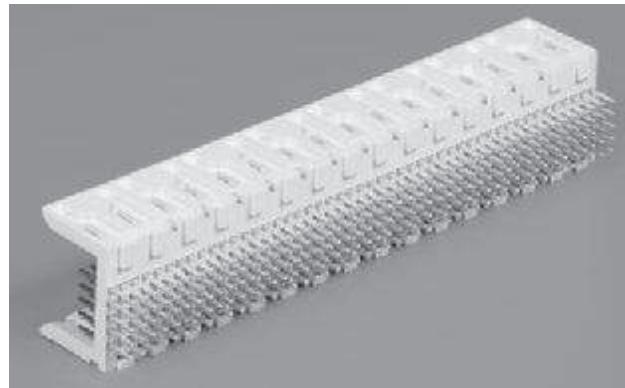
90°-Federleiste
240polig, Lötausführung
Best.-Nr. **223004-8**

90°-Federleiste
240polig, ACTION PIN
Best.-Nr. **223007-8**



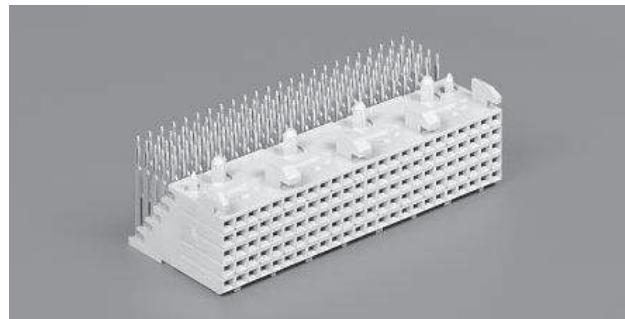
Messerleiste
240polig, Lötausführung 4,5 mm
Best.-Nr. **223010-8**

Messerleiste
240polig, ACTION PIN 4,25 mm
Best.-Nr. **223002-8**



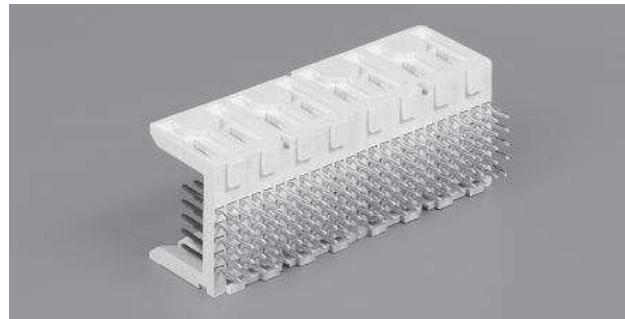
90°-Federleiste
120polig, Lötausführung
Best.-Nr. **223004-4**

90°-Federleiste
120polig, ACTION PIN
Best.-Nr. **223007-4**



Messerleiste
120polig, Lötausführung 4,5 mm
Best.-Nr. **223010-4**

Messerleiste
120polig, ACTION PIN 4,25 mm
Best.-Nr. **223002-4**

**AMP Products
for IndustrialPCI (IPCI)
(continued)****AMP Z-PACK 2 mm FB
5 Rows**

Female Connector 90°
240 positions, Solder Version
Part No. **223004-8**

Female Connector 90°
240 positions, ACTION PIN
Part No. **223007-8**

Male Connector
240 positions, Solder Version 4.5 mm
Part No. **223010-8**

Male Connector
240 positions, ACTION PIN 4.25 mm
Part No. **223002-8**

Female Connector 90°
120 positions, Solder Version
Part No. **223004-4**

Female Connector 90°
120 positions, ACTION PIN
Part No. **223007-4**

Male Connector
120 positions, Solder Version 4.5 mm
Part No. **223010-4**

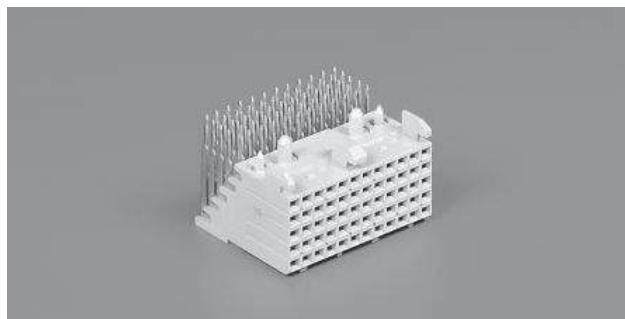
Male Connector
120 positions, ACTION PIN 4.25 mm
Part No. **223002-4**

**AMP Produkte
für IndustrialPCI (IPCI)
(Fortsetzung)**

**AMP Z-PACK 2 mm FB
5 Reihen**

90°-Federleiste
60polig, Lötausführung
Best.-Nr. **223004-2**

90°-Federleiste
60polig, ACTION PIN
Best.-Nr. **223007-2**



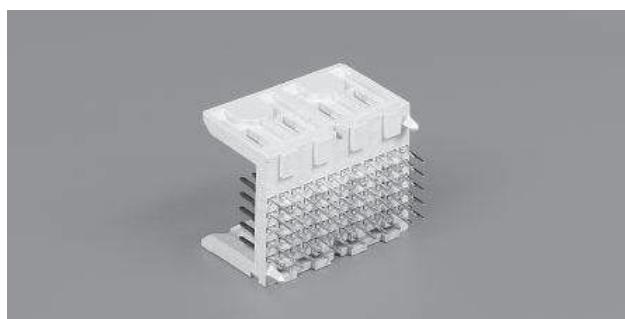
**AMP Products
for IndustrialPCI (IPCI)
(continued)**

**AMP Z-PACK 2 mm FB
5 Rows**

Female Connector 90°
60 positions, Solder Version
Part No. **223004-2**

Female Connector 90°
60 positions, ACTION PIN
Part No. **223007-2**

Messerleiste
60polig, Lötausführung 4,5 mm
Best.-Nr. **223010-2**



Male Connector
60 positions, Solder Version 4.5 mm
Part No. **223010-2**

Messerleiste
60polig, ACTION PIN 4,25 mm
Best.-Nr. **223002-2**

Male Connector
60 positions, Solder Version 4.25 mm
Part No. **223002-2**

**Universal
Hochstrom Modul**

Lieferbare Versionen:

Messerleiste
8polig, Lötausführung
Best.-Nr. **536600-1**

Messerleiste
8polig, ACTION PIN ohne Voreilung
auf Reihe B
Best.-Nr. **536603-1**

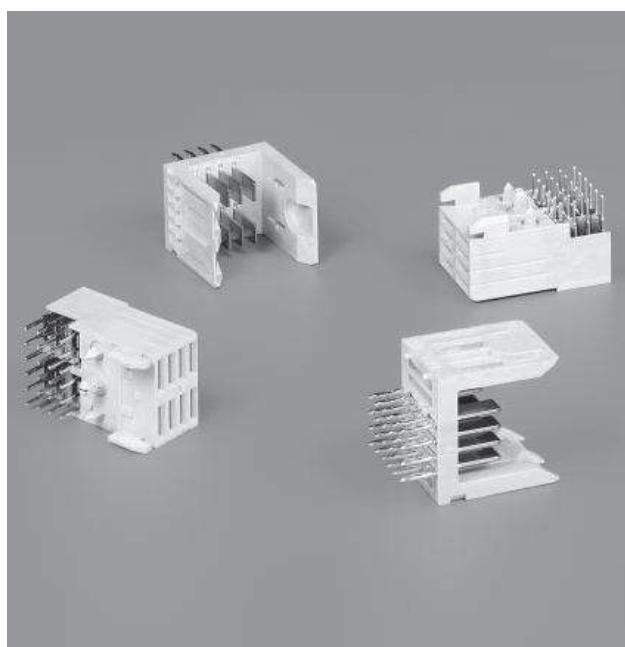
Messerleiste
8polig, ACTION PIN mit Voreilung
auf Reihe B
Best.-Nr. **536606-1**

Messerleiste
8polig, ACTION PIN mit Voreilung
auf Reihe A+B
Best.-Nr. **536619-1**

90°-Federleiste
8polig, Löt 2,73 mm
Best.-Nr. **536607-1**

90°-Federleiste
8polig, Löt 3,53 mm
Best.-Nr. **536613-1**

90°-Federleiste
8polig, ACTION PIN,
Best.-Nr. **536614-1**



**Universal
High Current Module**

Available Versions:

Male Connector
8 positions, Solder Version
Part No. **536600-1**

Male Connector
8 positions, ACTION PIN without
First Make/Last Break (FMLB)
Part No. **536603-1**

Male Connector
8 positions, ACTION PIN with First
Make/Last Break (FMLB) on Row B
Part No. **536606-1**

Male Connector
8 pos., ACTION PIN with First Make/
Last Break (FMLB) on Row A+B
Part No. **536619-1**

Female Connector 90°
8 positions, Solder Version 2.73 mm
Part No. **536607-1**

Female Connector 90°
8 positions, Solder Version 3.53 mm
Part No. **536613-1**

Female Connector 90°
8 positions, ACTION PIN
Part No. **536614-1**